#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Mpemba, E. B. Cool? / E. B. Mpemba, D. G. Osborne // Physics Education. Institute of Physics, 1969. T. 4, No 3. C. 172-175.
- 2. Ткачук, С. В. Моделирование процесса замерзания воды с помощью среды моделирования COMSOL MULTIPHYSICS / С. В. Ткачук, В. В. Борушко, В. И. Гладковский // Новые математические методы и компьютерные технологии в проектировании, производстве и научных исследованиях : сборник тезисов докладов XX Республиканской научной конференции студентов и аспирантов / ГГУ им. Франциска Скорины. Гомель, 2017. Ч. 1. С. 94–95.
- 3. Дегтярик, И. А. Моделирование «эффекта Мпембы» / И. А. Дегтярик, В. В. Борушко, В. И. Гладковский // Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов / БрГТУ; редкол. Н.Н. Шалобыта [и др.]. Брест, 2019. Ч.1. С. 69–71.

УДК 541.15

# МЕТОДИКА ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ СО-ПОКРЫТИЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

#### В. П. Евстигнеева, Н. Г. Валько

г. Гродно, УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Магнитные сплавы на основе Со, сформированные методом электролитического осаждения, широко используются в авиационной, автомобильной, приборостроительной и электронной промышленности. Поэтому актуальной задачей является разработка новых методик электроосаждения магнитных сплавов на основе Со с целью получения слоев с требуемыми эксплуатационными свойствами.

В работе представлена методика электроосаждения Со-покрытий из сульфатных электролитов при воздействии УФ-излучения, позволяющей увеличивать плотность Со-покрытий при интенсификации массового прироста вследствие радиационно-химических реакций, протекающих в облучаемых электролитах. Согласно [1–2] метод электроосаждения покрытий при воздействии излучения на электролит позволяет модифицировать структуру и свойства получаемых покрытий, вследствие радиационно-химических реакций, протекающих в облучаемых электролитах.

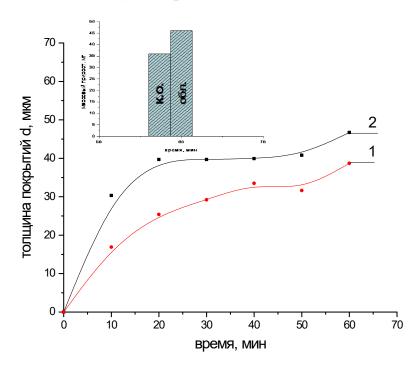
Методика электроосаждения Со-покрытий при воздействии УФ-излучения заключается в разработке режимов облучения УФ-излучением с целью увеличения плотности Со-покрытий на 35 % при возрастании за 1 ч массового прироста на 22 %. В таблице 1 представлен состав используемого сульфатного электролита.

Таблица 1 – Состав электролита для осаждения Со-покрытий

Компоненты электролита	Масса, г/л
Сернокислый кобальт, CoSO <sub>4</sub>	200
Борная кислота, Н <sub>3</sub> ВО <sub>3</sub>	21,25
Хлористый натрий, NaCl	8,75

Формирование покрытий происходит в поле УФ-излучения. Источником излучения служит эксимерная лампа на основе газовой смеси криптон-бром (KrBr), излучающая ультрафиолетовое излучение с длиной волны 207 нм. Термостатируемая при температуре 24  $^{\circ}$ С кювета для осаждения Со-покрытий располагается на расстоянии 15 см таким образом, чтобы плотность мощности излучения была не менее 5мВт/см<sup>2</sup>. Плотность тока электроосаждения равна  $1 \text{ A/лм}^2$ .

На рисунке 1 приведены зависимости толщины Со-покрытий от времени осаждения, а также их массовый прирост в единицу времени. Видно, что толщина покрытий, электроосаждаемых Со-покрытий в поле УФ-излучения уменьшается, а массовый прирост в единицу времени увеличивается. Полученные факты свидетельствуют об увеличении плотности покрытий, сформированных в поле УФ-излучения. Так, плотность покрытий, осаждаемых в течение 1 ч в поле, равна  $5,28 \, \text{г/см}^3$ , у контрольных  $3,43 \, \text{г/см}^3$ .



1 — облученные образцы, 2 — контрольные образцы Рисунок 1 — Зависимости толщины Со-покрытий от времени осаждения

Практическая значимость предлагаемой методики заключается в ее применении при разработке новых технологических основ радиационного модифицирования магнитных материалов, с целью повышения их эксплуатационных характеристик.

Следует отметить, что использование разработки в учебном процессе позволяет повысить эффективность обучения студентов физико-технического факультета и качество подготовки специальностей 1-31 04-01-02 (Физика, производственная деятельность), 1-31 04 01-03 «Физика (научно-педагогическая деятельность), 1-38 02-01 (Информационно-измерительная техника) за счет использования современных методов научного эксперимента.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Valko, N. Forming a structure of the CoNiFe alloys by X-ray irradiation / N. Valko, A. Kasperovich, T. N. Koltunowicz // Functional Materials Letters. 2018. T. 11, № 2. 1850044 (4 pages).
- 2. Valko, N. Electrodeposition of CoNiFe coatings in the presence of the X-rays / N. Valko, A. Kasperovich // Procedings of international conference. Nanomaterials: Applications and properties. Nap. -2016. Vol. 5, No 1. 01NTF15 (3pp).

УДК 535:621.373.8

## ФАКТОР ОПТИЧЕСКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ГЕТЕРОСТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ InGaN

### Н. П. Тарасюк

г. Брест, УО «Брестский государственный технический университет»

Применение гетероструктур InGaN/GaN являются перспективно для создания оптоэлектронных устройств, работающих в ультрафиолетовой-сине-зеленой области спектра.

В данной работе проводится оптимизация по фактору оптического ограничения толщин волноводных слоев различных дизайнов гетероструктур с активной областью, содержащей пять и десять квантовых ям InGaN.

Для моделирования фактора оптического ограничения гетероструктур была использована модель одномерной планарной структуры.

Вычисления фактора оптического ограничения были проведены в приближении плоских волн для TE поляризации излучения [1–3]. Напряженность электрического поля в j-м слое структуры представляется в виде:

$$\varepsilon_{y}(x,z,t) = \varepsilon_{y,j}(x) \exp[i(\omega t - \beta z)]. \tag{1}$$

Амплитуда напряженности электрического поля  $\varepsilon_{y,j}(x)$  удовлетворяет волновому уравнению:

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{y,j}(x)}{\partial x^2} - (\beta^2 - k_0^2 \widetilde{n}_j^2) \varepsilon_{y,j}(x) = 0, \qquad (2)$$

где  $\beta$  — проекция волнового вектора  $k_0$  на плоскость гетероструктуры,

 $\widetilde{n}_{j}$  — комплексный показатель преломления j-го слоя.

Для нахождения  $\beta$  использовался алгоритм скоростного спуска [1]. Фактор оптического ограничения вычислялся по формуле [4]:

$$\Gamma = \frac{\sum_{x=1}^{N} \int_{x_{bi}}^{X_{bi}} E_{y}^{2}(x)dx}{\int_{x=0}^{N} \int_{x_{bi}}^{X_{bi}} E_{y}^{2}(x)dx},$$
(3)

где интегрирование в числителе происходит по координатам квантовых ям InGaN.